



currenttecはプリント基板，テープ基材，先進パッケージ，エレクトロニクス材料分野での技術調査，ライセンス，コンサルタントを目的とした新しい会社です。

currenttecはコントラクト・ベースでマイクロエレクトロニクス分野での最新技術を提供し，国際ライセンス，コンサルタントを行います。

currenttecにはマイクロエレクトロニクス分野に経験のあるデザイン，機械，製造，品質管理，マーケティングの専門家数名が在籍し，これらの専門家が顧客の要請に応じてカスタムメイドの調査，分析を行います。

currenttecの事業内容は下記のとおりです。

1. プリント基板，テープ基材，先進パッケージ，エレクトロニクス材料分野の企画と技術サポート
 - 高密度基板
 - BGA, CSP, MCM用基板
 - ビルドアップ技術
 - レーザー加工技術
2. プリント基板，テープ基材，先進パッケージの新工場の企画・設計
 - トータルプラン
3. マイクロエレクトロニクス分野の国際ライセンスとコンサルタント
 - 現状および未来技術
 - 技術移転
4. マイクロエレクトロニクス製品の技術サポート，マーケティング，および代理店
 - マーケット開発
 - 先端製品の代理店業務
5. マイクロエレクトロニクス会社のM&A（併合・取得）

契約はプロジェクト毎に行われ，契約料は月次またはプロジェクトが完了した時点でのサクセス・フィーとして支払われます。プロジェクトのターゲットは契約に明示されます。プロジェクトの例は下記のとおりです。

- ビルドアップ技術のコスト分析と信頼性比較
- 広幅テープ生産，コスト競争力とトレードオフ
- 新しいTABテープ工場の企画，プラント設計と設備仕様
- 新製品のマーケット戦略



有限会社 カレンテック

社長：平川 董

住所：564-0052大阪府吹田市広芝町9-31-705

Tel: 06-6338-1026, Fax: 06-6338-1024

携帯電話：090-476-06123

E-mail: currenttec.hirakawa@nifty.ne.jp